

昭和電工と昭和電工マテリアルズ(旧：日立化成)は2023年1月1日に統合し
新会社 **レゾナック** が誕生しました。

RESONAC

Chemistry for Change

統合新会社レゾナックは「**化学の力で社会を変える**」をパーパスに掲げています。
しかし、さまざまな社会課題を解決するための技術革新には、パートナーとの幅広い共創が欠かせません。
レゾナックは「**共創型化学会社**」として、共創を通じて持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。

新社名の「RESONAC」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、CHEMISTRYの「C」を組み合わせることから生まれました。
当社グループの持つ幅広く自在な先端材料テクノロジーと、パートナーの持つさまざまな技術力と発想が
強くつながり大きな「共鳴」を起こし、その響きが広がることでさらに新しいパートナーと出会い、
社会を変える大きな動きを創り出していきたいという強い想いを込めています。

昭和電工

電気化学をルーツにもつ昭和電工の技術は、無機化学・有機化学・金属材料へ発展を遂げ、現在は情報通信産業、自動車産業に用いられる素材・部材や生活に必要なさまざまな製品に受け継がれています。

● 1908

沃度製造会社設立
(日本沃度(株)の母体、
のちの日本電気工業(株))

● 1931

国産法による硫酸を
製造 (昭和肥料(株))

● 1934

国産アルミニウムを
工業化 (日本沃度(株))



● 1939

昭和電工(株)設立
(日本電気工業(株)と昭和
肥料(株)が合併)

● 1951

合成樹脂エマルジョンを
国産化 (昭和高分子(株))

● 1969

大分石油化学コンビナート
営業運転開始



● 1986

アルミニウムシリンダーの
製造販売開始
(昭和アルミニウム(株))



● 1988

ハードディスク事業へ進出



● 2001

昭和アルミニウム(株)を合併

● 2003

プラスチックケミカル
リサイクル事業開始



● 2009

パワー半導体用冷却器の
生産開始



● 2010

昭和高分子(株)を合併

● 2016

韓国で半導体用高純度
ガスの合併会社設立

● 2017

ドイツSGL GE社の
黒鉛電極事業を買収



● 2020

日立化成(株)が
グループに加わる
(現: 昭和電工
マテリアルズ(株))

昭和電工 マテリアルズ

4つの源流製品である「絶縁ワニス」「積層板」「絶縁ガイシ」「カーボンブラシ」を通じて蓄積された有機・無機化学にまたがる深いノウハウが、昭和電工マテリアルズの基盤技術を築き、それらを複合・融合させることでさまざまな製品を生み出してきました。

● 1912

電気絶縁ワニス国産化
に向け研究開始
(旧 日立化成(株)創業)



● 1930

フェノール樹脂積層板の
試作開始

● 1931

絶縁ガイシの施策開始

● 1933

カーボンブラシの
試作開始

● 1955

プリント配線板用
銅張積層板「MCL」
の製造開始



● 1974

医薬品 (MS-アンチゲン)
の製造開始

● 1978

アルカリ現像感光性
フィルム「フォテック」の
販売開始

● 1984

ディスプレイ用回路接続
フィルム「ANISOLM」の
製造開始



● 1992

耐リフロー性エポキシ樹脂
封止材の販売開始

● 1998

リチウムイオン電池用
負極材の量産開始
STI用CMPスラリーの
製造開始



● 2001

日本初の樹脂製バックア
モジュールの製造開始



● 2008

33項目同時測定
アレルギー診断薬の
製造開始

● 2017

再生医療等製品の
製法開発・受託製造
事業に参入



● 2020

昭和電工グループに
加わる (昭和電工
マテリアルズ(株)へ)

2023
法人格を
完全統合



本社

東京都港区東新橋1-9-1

設立

1939 年 6 月

資本金

1,821 億円

従業員数

連結 25,803 名 (2022年FY)

売上高

1兆3,926 億円 (2022年FY)

事業内容

各種化学品・素材、製品・サービスなどの
研究・開発・製造・販売

株式会社レゾナック・ホールディングス
株式会社レゾナック



Purpose / 存在意義

化学の力で社会を変える

先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、
グローバル社会の持続可能な発展に貢献する

Values / 私たちが大切にする価値観

プロフェッショナルとしての
成果へのこだわり

枠を超えるオープンマインド

機敏さと柔軟性

未来への先見性と高い倫理観



その他

8%

ライフサイエンス など
再生医療等製品の製法開発・受託製造
体外診断用医薬品 等

ケミカル

38%

黒鉛電極
化学品
産業ガス
基礎化学品 等

石油化学
オレフィン
有機化学品 等

イノベーション材料

10%

機能性化学品 (樹脂材料 等)、セラミックス
アルミニウム機能部材、コーティング材料 等



半導体・電子材料

31%

半導体前工程材料

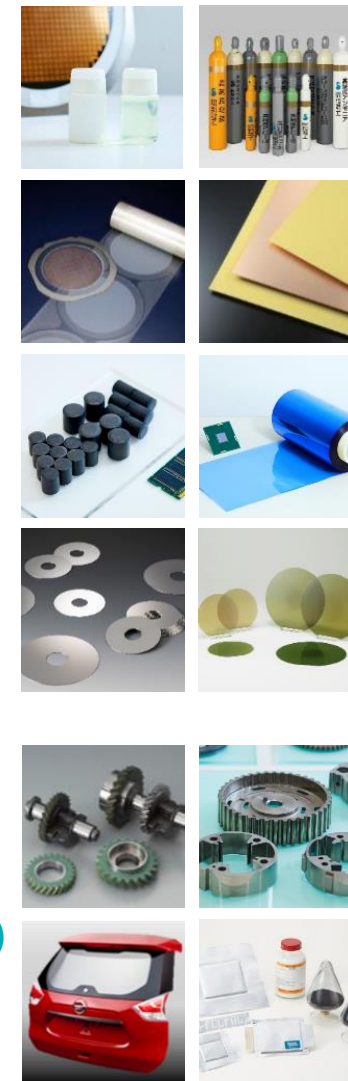
ガス製品、研磨材料、高純度溶剤 等

半導体後工程材料

封止材料、銅張積層板
ダイボンディング材料
感光性フィルム 等

デバイスソリューション

ハードディスクメディア
SiCエピタキシャルウェハ
化合物半導体 (LED) 等



モビリティ

13%

リチウムイオン電池材料

ラミネートフィルム、導電助剤
カーボン負極材 等

自動車部品

樹脂成型品
ブレーキパッド
粉末冶金製品 等

電子材料用高純度ガス

(C_4F_6 、HBr、 Cl_2 世界No.1)

半導体製造時に必要なエッチング、成膜材料として使用



黒鉛電極 (世界No.1)

電気製鋼炉での鉄鋼生産時に
鉄スクラップを溶かすために使用



ハードディスク (専業メーカー 世界No.1)

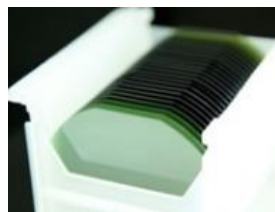
世界初の垂直磁気記録方式の量産化に成功
ハードディスクドライブのデータ記録媒体に使用



SiCエピタキシャルウェハ

(外販メーカー 世界No.1)

電力制御用モジュールの軽量・小型化と高効率化の実現
省エネルギー化が期待できる 次世代のパワー半導体材料



アルミラミネート包材SPALF®

(リチウムイオン電池用 世界No.2)

スマートフォンなどのリチウムイオン電池に使用



CMPスラリー (セリアスラリー 世界No.1)

半導体回路形成工程で生じた、絶縁膜や配線層などの
凹凸を平坦化するために使用



ダイボンディング材料 (世界No.1)

ICチップをリードフレーム、パッケージ基板などに
接着するために使用



感光性フィルム (世界No.1)

プリント配線板の製造の際、銅張積層板の上に貼り付け
回路を形成するために使用



封止材 (世界No.2)

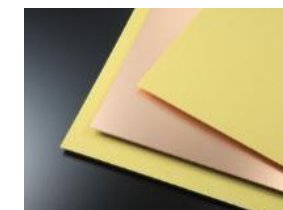
ICチップを温度、湿度、ほこり、物理的衝撃などから
保護するために使用



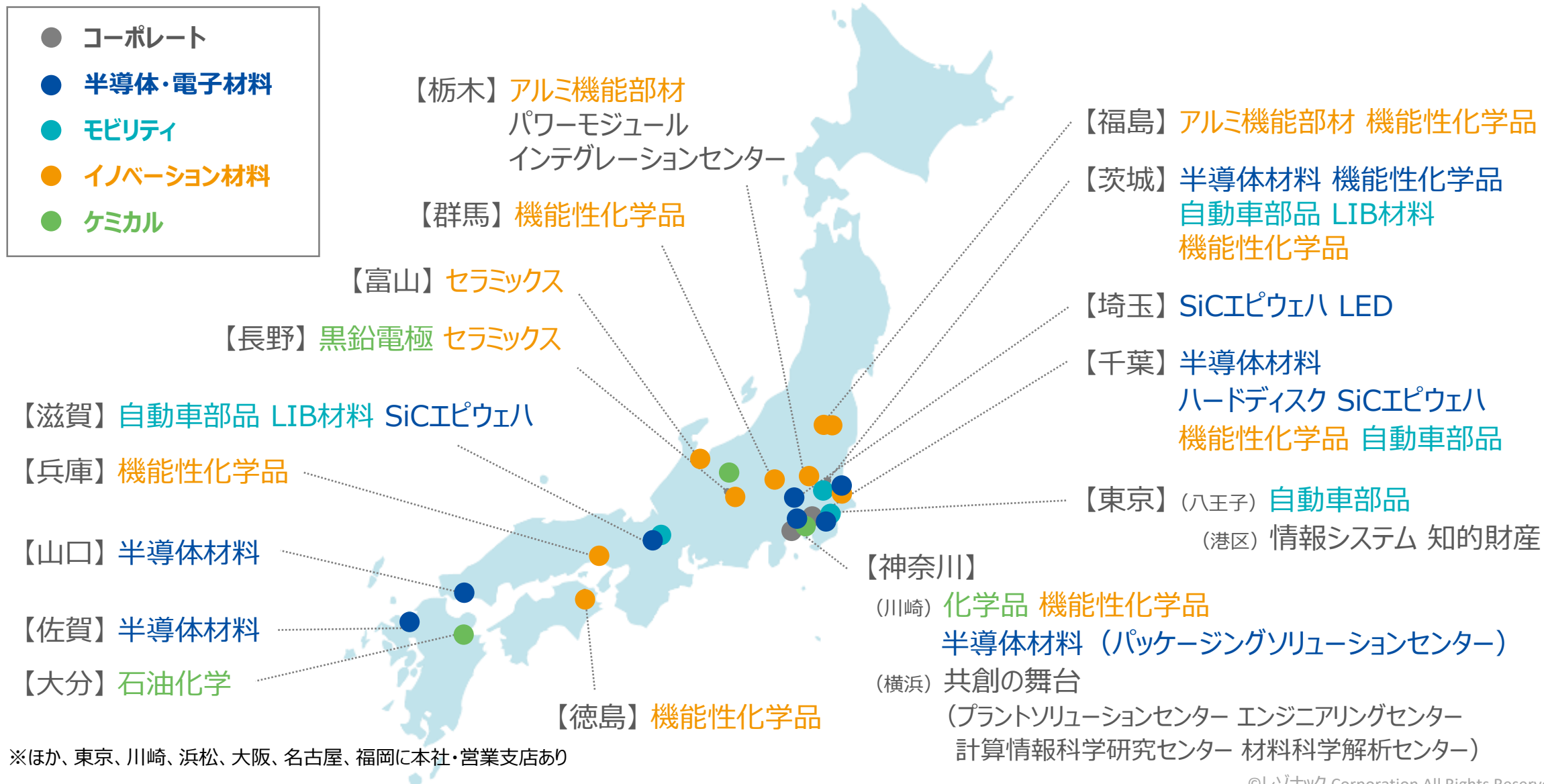
銅張積層板

(FC-BGA用 世界No.1)

プリント配線板や半導体パッケージの基板として使用



(シェアは当社推定)



社内外の共創により、持続可能な社会の実現に向けた課題解決に挑む

「共創の舞台」(横浜市神奈川区)



- ・事業横断の融合により、**多様な技術領域を繋いだ研究開発テーマの創出・推進**を担う
- ・**共通支援センター機能**により事業横断的な技術支援
- ・地域～海外に開いた施設とし、**オープンイノベーション**など**社外との協創機能**も持つ

取組みテーマ例

次世代高速通信用材料及びコンポジット開発



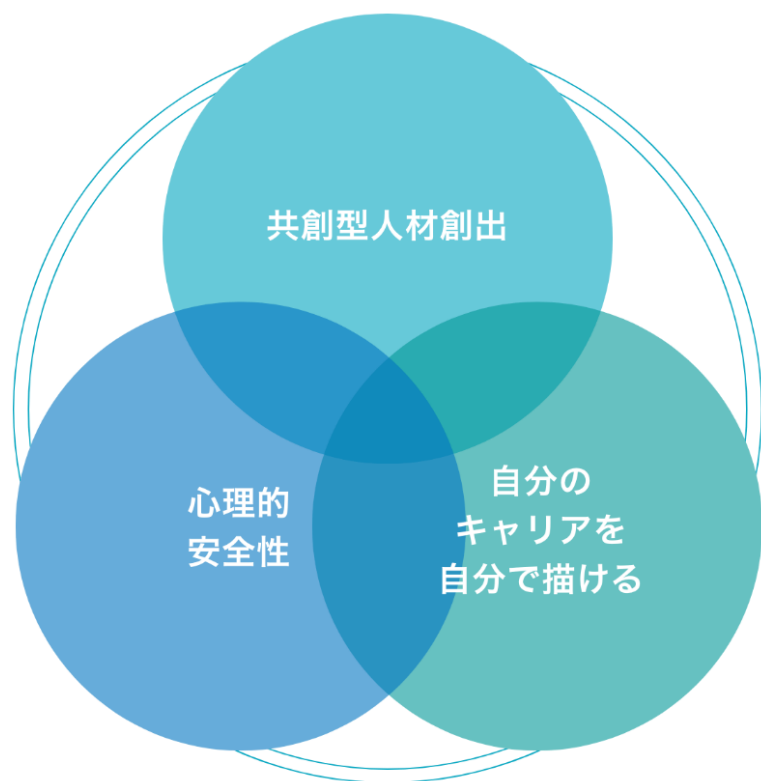
昭和電工の無機材料技術・有機合成技術と昭和電工マテリアルズの複合化技術を活用しBeyond 5Gに求められる要素技術・新素材を創出

プラスチックリサイクル



循環型ケミカルリサイクルへの期待が高まる中で、社会を支える基礎化学製品の「原料・製法転換」「炭素資源循環」を目的に、廃プラスチック-to-基礎化学原料技術の開発に挑戦

共創型人材×心理的安全性×キャリアオーナーシップ



共創型人材の創出

パーパス・バリューを体現する共創型人材の創出に向けて、
「パーパス・バリューの自分ごと化」「多様なキャリア開発・能力開発支援」
「社員が互いの専門性を知り活用するきっかけとなる共創の場づくり」を重視

心理的安全性

パフォーマンスが高いチームをつくるために、
チームメンバー全員で「心理的安全性」を生み出すための活動と
個人が「挑戦」「積極的・率直な発言」「仕事の意味意義の認識」を生み出す活動を支援

キャリアオーナーシップ

一人ひとりが個々の強みを活かし、磨き上げるための機会を自分で選択できる環境

RESONAC